



RM

COMPONENTS

TAIYO YUDEN

POWER CHIP INDUCTORS

Top Values

Automotive (A, c), Industrial (B),
Medical (M, L), Consumer (S)

**big service on
small products**

Design-In Spezialist Für Elektronische High-End Bauelemente

Wir sind auf den Vertrieb von TAIYO YUDEN (Japan) und HolyStone (Taiwan) spezialisiert. Für beide Hersteller sind wir der größte Distributionspartner in Europa, unterhalten Europas größtes Warenlager und liefern passive Bauteile für nahezu alle elektronischen Applikationen. Gleichzeitig bieten wir unseren Kunden umfangreichen

technischen und logistischen Support. So stellen wir die verlässliche Versorgung mit technisch passenden Bauteilen sicher.

Unser Partner TAIYO YUDEN ist Marktführer im Bereich Keramikkondensatoren, Induktivitäten & Ferriten. Er hebt sich durch technologischen Fortschritt, Versorgungssicherheit und einem

sehr hohen Automatisierungsgrad von Marktbegleitern ab.

Auf den folgenden Seiten haben wir eine Bauteilauswahl mit Top-Werten getroffen, um Ihnen das Portfolio von TAIYO YUDEN als Hersteller von Induktivitäten und Ferriten näher zu bringen (Zwischenbauformen für alle Serien verfügbar).

Einführung Neuer Hersteller-Teile-Nummern (HTN)


TAIYO YUDEN hat Änderungen an den Teilenummern seiner Produkte vorgenommen. Durch die Einführung des neuen Hersteller-Teile-Nummer-Systems

(HTN) wird gewährleistet, dass alle Produkte für den korrekten Zielmarkt und Einsatzzweck ausgewählt werden können. Das neue Nummernsystem wird es Ihnen

erleichtern, die korrekten Teile für Ihre Anwendung zu bestellen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Produkt Gruppe	Grade	Typ	Charakteristik																

Anwendung	Produktserie		Qualitätsstufe
	Einsatzgebiet	Grade	
Automotive	Automotive Electronic Equipment (POWERTRAIN, SAFETY)	A	1
	Automotive Electronic Equipment (BODY & CHASSIS, INFOTAINMENT)	C	2
Industrial	Telecommunications Infrastructure and Industrial Equipment	B	2
Medical	Medical Devices classified as GHTF Class C (Japan Class III)	M	2
	Medical Devices classified as GHTF Classes A or B (Japan Classes I or II)	L	3
Consumer	General Electronic Equipment	S	3

* HTN = Hersteller Teile Nummer  = Platzhalter für Grade (A, C, B, M, L oder S)

Beispiel:

L RNJ10145GL

Verfügbar in den Grades **C, B, M, L**

Somit ist dieses Bauteil verfügbar in folgenden Varianten/HTN:

L C RNJ10145GL

L B RNJ10145GL

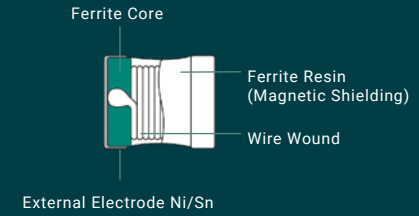
L M RNJ10145GL

L L RNJ10145GL

Wire Wound Ferrite Core Chip Inductors

Die neue L²QB- & L²QC-Serie

- Vorherige HTN*: LB-, CB-Serie
- Magnetische Schirmung durch Ferritummantelung
- Volumen wird vollständig ausgenutzt
- Hoher Wirkungsgrad
- Vollflächige Anschlusselektroden
- Mechanischer Schutz
- Hervorragende Rauschunterdrückung
- Temperaturbereich -40 bis +105°C



verfügbar in B, M, L, S

Größe L x B x H (HTN Alt)	1.6 x 0.8 x 0.9 mm (LB1608)	2.0 x 1.6 x 1.8 mm (LB2016)	3.2 x 1.8 x 2.0 mm (LB3218)	1.6 x 0.8 x 1.0 mm (LBMF1608)	2.0 x 1.6 x 1.8 mm (LBC2016)	2.5 x 1.8 x 2.0 mm (LBC2518)	3.2 x 2.5 x 2.7 mm (LBC3225)
HTN Neu	L²QBA160808	L²QBA201616	L²QBA321818	L²QBB160808	L²QCA201616	L²QCA251818	L²QCA322525
	1.0 µH – 10 µH 160 mA – 60 mA	1.0 µH – 100 µH 490 mA – 40 mA	1.0 µH – 1000 µH 1075 mA – 39 mA	1.0 µH – 47 µH 230 mA – 35 mA	1.0 µH – 100 µH 690 mA – 75 mA	1.0 µH – 680 µH 775 mA – 45 mA	1.0 µH – 100 µH 1.1 A – 150 mA

MCOIL™ – Wire Wound Metal Core Power Chip Inductors

L²BHB-Serie

- Vorherige HTN*: MB-Serie
- Power-Up zur L²QB- & L²QA-Serie
- Niedriger RDC, hoher Sättigungsstrom
- Ausgezeichnete DC-Bias Charakteristika
- Temperaturbereich: -40 bis +125°C



verfügbar in L, S

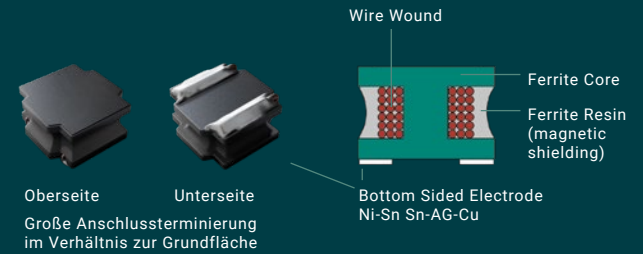
Größe L x B x H (HTN Alt)	1.6 x 0.8 x 1.0 mm (MBKK1608)	2.0 x 1.25 x 1.0 mm (MBKK2012)	2.5 x 2.0 x 1.2 mm (MBMK2520)
HTN Neu	L²BHB1608KK	L²BHB2012KK	L²BHB2520MK
	0.24 µH – 4.7 µH 1.65 A – 370 mA	0.24 µH – 4.7 µH 2.4 A – 600 mA	0.24 µH – 4.7 µH 3.5 A – 800 mA

Ferrite Core Power Chip Inductors

AEC-Q200 Qualified

Die neue L_XN_D- & L_XN_H- (NRS), L_XN_E- (NRH), L_XPD (NRV)-Serien

- Vorherige HTN*: NRS-, NRH-, NRV-Serien
- Platzsparend
- Mit Ferritharz ausgegossen, somit magnetische Schirmung
- Hoher Strom, niedriger RDC
- Mechanischer Schutz
- Robust bei Temperaturzyklen
- Hart und robust gegen Vibration und Durchbiegung aufgrund der Ferritlackierung
- Unser High Runner
- Temperaturbereich: -40 bis +125°C



L_XN_D- & L_XN_H-Serie

verfügbar in C, B, M, L, S

Größe L x B x H (HTN Alt)	2.0 x 2.0 x 1.2 mm (NRS2012)	3.0 x 3.0 x 1.5 mm (NRS3015)	4.0 x 4.0 x 1.2 mm (NRS4012)	5.0 x 5.0 x 1.0 mm (NRS5010)	5.0 x 5.0 x 4.0 mm (NRS5040)	6.0 x 6.0 x 4.5 mm* (NRS6045)	8.0 x 8.0 x 3.0 mm (NRS8030)	8.0 x 8.0 x 4.0 mm (NRS8040)	8.0 x 8.0 x 4.2 mm (NRS8040)
HTN Neu	L_XN_D2020MK	L_XN_D3030QK	L_XN_D4040MK	L_XN_D5050KK	L_XN_D5050YK	L_XN_D6060YE	L_XN_H8080XK	L_XN_H8080YK	L_XN_H8080YB
	1 µH – 4.7 µH 1.7 A – 900 mA	1 µH – 47 µH 2.1 A – 325 mA	1 µH – 47 µH 2.2 A – 350 mA	1 µH – 22 µH 1.75 A – 450 mA	15 µH – 47 µH 1.8 A – 900 mA	1 µH – 100 µH 4.5 A – 750 mA	1 µH – 47 µH 6.2 A – 1.1 A	10 µH – 220 µH 3.1 A – 670 mA	0.9 µH – 6.8 µH 7.8 A – 3.7 A



L_XN_E-Serie

verfügbar in C, B, M, L, S

L_XPD-Serie

verfügbar in C, B, M, L, S

Größe L x B x H (HTN Alt)	2.4 x 2.4 x 1.0 mm (NRH2410)	2.4 x 2.4 x 1.2 mm (NRH2412)	3.0 x 3.0 x 1.0 mm (NRH3010)	3.0 x 3.0 x 1.2 mm (NRH3012)	2.0 x 2.0 x 1.0 mm (NRV2010)	2.0 x 2.0 x 1.2 mm (NRV2012)	3.0 x 3.0 x 1.2 mm (NRV3012)
HTN Neu	L_XN_E2424KK	L_XN_E2424MK	L_XN_E3030KK	L_XN_E3030MK	L_XPD2020KK	L_XPD2020MK	L_XPD3030MK
	0.68 µH – 22 µH 1.57 A – 300 mA	0.47 µH – 10 µH 2.1 A – 450 mA	1.2 µH – 47 µH 1.48 A – 250 mA	0.47 µH – 47 µH 1.9 A – 280 mA	0.47 µH – 4.7 µH 2 A – 760 mA	1 µH – 4.7 µH 1.65 A – 750 mA	1 µH – 10 µH 1.6 A – 550 mA

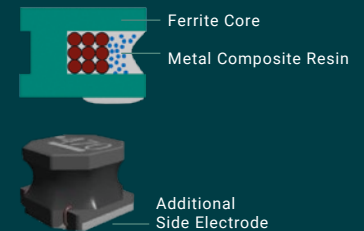
* auch in H=1 mm verfügbar.

Ferrite Core & Metal Resin Power Chip Inductors – The Hybrids

AEC-Q200 Qualified

LXHF-Serie

- Vorherige HTN*: NRM-Serie
- Sehr robust
- Niedriger RDC
- AOI durch seitliche Lötaderweiterung möglich
- Klein und niedriges Profil
- Nochmals verbessertes DC-Bias Verhalten und höhere Sättigungsströme im Vergleich zur LXND-Serie (Vorherige HTN: NRS)
- Geeignet für DC/DC Wandler
- Temperaturbereich -40 bis +125°C



	verfügbar in C, B, M					
Größe L x B x H (HTN Alt)	3.0 x 3.0 x 1.5 mm (NRM3015)	4.0 x 4.0 x 2.0 mm (NRM4020)	5.0 x 5.0 x 2.2 mm (NRM5020)	5.0 x 5.0 x 3.1 mm (NRM5030)	6.0 x 6.0 x 3.0 mm (NRM6030)	6.0 x 6.0 x 4.5 mm (NRM6045)
HTN Neu	LXHF3030QK	LXHF4040WK	LXHF5050WB	LXHF5050XA	LXHF6060XA	LXHF6060YE
	0.47 µH – 100 µH 3.1 A – 210 mA	1.0 µH – 220 µH 3.66 A – 330 mA	0.47 µH – 100 µH 6.0 A – 500 mA	0.47 µH – 470 µH 6.8 A – 250 mA	1.0 µH – 100 µH 5.8 A – 730 mA	1.0 µH – 470 µH 6.2 A – 380 mA

LAXHG-Serie - For Automotive Powertrain And Safety

- Vorherige HTN*: NRT-Serie
- Speziell entwickelt für hohe Anforderungen
- Gleiche Vorteile wie LXHF-Serie
- Temperaturbereich: -40 bis +150°C

	verfügbar in A		
Größe L x B x H (HTN Alt)	5.0 x 5.0 x 3.0 mm (NRT5030)	5.0 x 5.0 x 3.1 mm (NRT5030)	6.0 x 6.0 x 4.5 mm (NRT6045)
HTN Neu	LAXHG5050XK	LAXHG5050XA	LAXHG6060YE
	47 µH – 470 µH 850 mA – 250 mA	0.47 µH – 22 µH 6.8 A – 1.3 A	1.0 µH – 470 µH 6.2 A – 380 mA

MCOIL™ – Metal Core Power Chip Inductors

AEC-Q200 Qualified

L■DND-Serie

- Vorherige HTN*: MD-Serie
- Metal Core SMD Power Induktivitäten
- Kleine Bauformen und hohe Ströme
- Temperaturbereich: -40 bis +125°C



● ● ● ● ● ● ● ●

verfügbar in C, B, M, L, S

Größe L x B x H (HTN Alt)	1.64 x 1.64 x 1.0 mm (MDKK1616)	2.0 x 2.0 x 1.0 mm (MDKK2020)	3.0 x 3.0 x 1.0 mm (MDKK3030)	2.0 x 2.0 x 1.2 mm (MDMK2020)	3.0 x 3.0 x 1.2 mm (MDMK3030)	4.0 x 4.0 x 1.2 mm (MDMK4040)	5.0 x 5.0 x 1.4 mm (MDPK5050)
HTN Neu	L■DND1616KK	L■DND2020KK	L■DND3030KK	L■DND2020MK	L■DND3030MK	L■DND4040MK	L■DND5050PK
	0.47 µH – 15 µH 1.5 A – 400 mA	0.47 µH – 15 µH 2.2 A – 480 mA	0.47 µH – 10 µH 3.9 A – 850 mA	0.47 µH – 4.7 µH 2.3 A – 950 mA	0.30 µH – 4.7 µH 5.5 A – 1.35 A	0.47 µH – 10 µH 4.6 A – 1.4 A	1 µH – 10 µH 4.3 A – 1.7 A

High Power Chip Inductors

AEC-Q200 Qualified

L■RNJ-Serie

- Vorherige HTN*: NS-Serie
- Hochstromspule mit Ferritgehäuse
- Hoher Sättigungsstrom und niedriger RDC
- Magnetische Schirmung

Anwendungen:

- Stromversorgung / DC-DC Converter
- Ansteuerung für LED Backlight, LCD u.v.m.
- Temperaturbereich: -40 bis +125°C



● ● ● ● ● ● ● ●

verfügbar in C, B, M, L, S

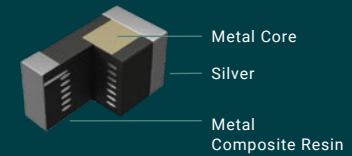
Größe L x B x H (HTN Alt)	10.1 x 10.1 x 4.85 mm (NS10145)	10.1 x 10.1 x 5.85 mm (NS10155)	10.1 x 10.1 x 6.85 mm (NS10165)	12.5 x 12.5 x 5.85 mm (NS12555)	12.5 x 12.5 x 6.85 mm (NS12565)	12.5 x 12.5 x 7.5 mm (NS12575)
HTN Neu	L■RNJ10145GL	L■RNJ10155GL	L■RNJ10165GL	L■RNJ12555GL	L■RNJ12565GL	L■RNJ12575GL
	1.0 µH – 1.5 mH 8.9 A – 270 mA	1.5 µH – 22 µH 8.39 A – 3.12 A	1.5 µH – 22 µH 8.04 A – 3.41 A	6.0 µH – 1.5 mH 5.01 A – 400 mA	2.0 µH – 220 µH 7.6 A – 1.18 A	1.2 µH – 1mH 9.15 A – 680 mA

MCOIL™ – Metal Core Chip Inductors

AEC-Q200 Qualified (Nur LCNF)

LCNB-, LCNA- & LCNF-Serie – Kleinste Multilayer Metall Power Chipdrosseln

- Vorherige HTN*: MC-Serie
- Verwendung von metallischen und magnetischen Materialien
- Perfekt zur Rauschunterdrückung an Leistungsschaltkreisen
- Exzellente DC-Bias Charakteristika
- Temperaturbereich: LCNB- & LCNA-Serie -40 bis +125°C
- Temperaturbereich: LCNF-Serie -55 bis +150°C
- NEU: Grade A (Automotive Powertrain And Safety) mit einem Temperaturbereich von -55 bis 165°C (nur verfügbar in der Größe 2.0 x 1.25 x 1.0 mm)



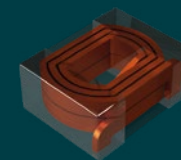
verfügbar in L, S						verfügbar in A, C, B, M		
Größe L x B x H (HTN Alt)	1.0 x 0.5 x 0.55 mm (MCEE1005)	1.25 x 1.05 x 0.5 mm (MCEK1210)	1.6 x 0.8 x 0.8 mm (MCHK1608)	1.6 x 0.8 x 1.0 mm (MCKK1608)	2.0 x 1.25 x 1.0 mm (MCKK2012)	Größe L x B x H (HTN Alt)	1.6 x 0.8 x 1.0 mm (MCKK1608)	2.0 x 1.25 x 1.0 mm (MCKK2012)
HTN Neu	LCNB1005EE	LCNB1210EK	LCNB1608HK	LCNB1608KK	LCNA2012KK	HTN Neu	LCNF1608KK	LCNF2012KK
	0.1 µH – 1 µH 2.0 A – 800 mA	0.47 µH – 1.5 µH 1.6 A – 900 mA	0.24 µH – 2.2 µH 3.7 A – 1.2 A	0.24 µH – 1.0 µH 2.6 A – 1.3 A	0.24 µH – 1.0 µH 4.0 A – 2.1 A		0.24 µH – 0.56 µH 3.2 A – 2.3 A	0.24 µH – 1.0 µH 4.8 A – 2.7 A

MCOIL™ – Wire Wound Metal Power Chip Inductors

AEC-Q200 Qualified

LCEN-Serie

- Vorherige HTN*: MEKK-Serie
- Technische Verbesserung des Magnetkerns und der Verbindung zum PCB (Terminierung)
- Sehr hohe Zuverlässigkeit und verbesserte Lebensdauer durch die Verwendung neuer Metallmaterialien mit hoher Hitzebeständigkeit
- Temperaturbereich: -40 bis +125°C



verfügbar in C, B, M, L, S			LCEN	LCEN Automotive
Größe L x B x H (HTN Alt)	2.0 x 1.6 x 1.0 mm (MEKK2016)	2.5 x 2.0 x 1.0 mm (MEKK2520)	LCEN	LCEN Automotive
HTN Neu	LCENC2016	LCENC2520	Structure	Structure
	0.24 µH – 2.2 µH 5.4 A – 1.9 A	0.33 µH – 4.7 µH 5.1 A – 1.5 A	Bottom Sided Electrode	Electrodes On Five Sides
			Terminal	Terminal
			One Sided Ag-Ni-Sn Electrode For High Density Mounting	Metal Resin Composite With Higher Heat Resistance Enamelled Flat Cu Wire Five Sided Ag-Ni-Sn Electrode

Ferrite Beads / Chip Filter For Data Line And Power Supply

High Current Up To 7.5 A Or High Impedance Up To 2.000 Ohm


AEC-Q200 Qualified

L_{MC}- & L_{MG}-Serie, Ferritperlen zur Entstörung


Gesamtes Wertespektrum bei RMC verfügbar

- Hohe Strombelastbarkeit
- Hohe Zuverlässigkeit
- Wellenformkorrektur von Digitalsignalen und Unterdrückung von hochfrequentem Rauschen
- Temperaturbereich: -40 bis +125°C
LAMG_16808 For Automotive Powertrain And Safety: -40 bis +150°C

verfügbar in C, B, M, L, S

High Current (A)				Über 1 A Line-up [A]							Impedance [Ω]
Bauteil	HTN Neu	HTN Alt	Bauform Inch	1	2	3	4	5	6	7	
	L _{MC} _160808	FBMJ1608	0603					4 – 7.5			18 – 28
	L _{MC} _201208	FBMJ2125	0805					4 – 6			8 – 42
	L _{MC} _321611	FBMJ3216	1206					4 – 6			16 – 80
	L _{MC} _451611	FBMJ4516	1806				3.5 – 6				23 – 110

verfügbar in A, C, B, M, L, S

High Impedance (Ω)											Impedance [Ω]	
	L _{MG} _160808	FBMH1608	0603		0.5 – 3.5							
	L _{MGA} 201208	FBMH2012	0805			1.8 – 2.7						80 – 330
	L _{MGA} 201616	FBMH2016	0806			2 – 4.5						120 – 250
	L _{MGA} 321616	FBMH3216	1206			2 – 4						220 – 500
	L _{MGA} 322525	FBMH3225	1210		1.2 – 3							600 – 2000
	L _{MGA} 451616	FBMH4516	1806		1.5							850
	L _{MGA} 452525	FBMH4525	1810			2 – 3						1000 – 1600
	L _{MGA} 453232	FBMH4532	1812		1.3 – 4							680 – 2000